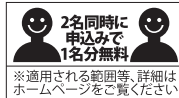




電子デバイスの基礎、パッケージング技術の基礎、  
現在および将来のパッケージング技術は何を求められてそれぞれの形態・方式となったのか、なるのか

# 【Live配信(リアルタイム配信)】 半導体パッケージ技術の進化、潮流、変遷、要素技術と AI、IoT、5G時代の革新からの要求への回答



**日時** 2020年10月28日(水) 10:30~16:30 **会場** Live配信セミナー ※会社・自宅にしながら学習可能です※

**受講料** 49,500円 ⇒テレワーク応援キャンペーン **【Live配信/WEBセミナー受講限定】**  
1名申込みの場合:受講料 定価:35,200円/S&T会員 33,440円 **資料付**  
※ 同一企業から複数名S&T会員で受講される場合は本割引ではなく、「2名同時申込みで1名分無料」割引を適用させていただきます。

**講師** (株)ISTL 代表取締役社長 博士(工学) 磯部 晶 氏 ※元NEC/東京精密/ニッタハース/ディスコ

**趣旨** AI、IoT、5G時代の到来により、電子デバイスとそのパッケージング技術には様々な革新が求められています。求められるデバイスには必ずしも「先端品」と一括りにされるものではなく、用途別に求められるパッケージング技術も異なってきます。本セミナーでは、電子デバイスの基礎、パッケージング技術の基礎から学び、現在および将来のパッケージング技術が何を求められてそれぞれの形態・方式となったのか、またそのための要素技術は何なのかについて解説します。

<b>プログラム</b>	1. AI、IoT、5G時代の到来 ○AI、IoT、5Gって何? ○AI、IoT、5Gに求められるデバイスは?	○各パッケージ方式と要素技術の説明 ○DIP、QFP ○ワイヤボンディング ○TAB ○BGA ○フリップチップ ○MEMS ○イメージセンサー ○様々なSiP ○CoWoSとは? ○FOWLPとは?	○ダイボンディング ○モールディング ○バンブ ○パッケージ基板 ○電子部品のパッケージ ○SAWデバイス ○最新のパッケージ技術 ○基板接合技術の展開 ○チップレットとは? ○部品内蔵基板とは?
	2. 最終製品の進化とパッケージの変化 ○電子デバイスの分類 ○電子部品の分類 ○実装方法の変遷	○i-PHOPNEを分解してみよう ○能動部品と受動部品 ○半導体の基礎、種類と特徴	
	3. 半導体パッケージの役割とは ○前工程と後工程 ○半導体パッケージへの要求事項		
	4. 半導体パッケージの変遷 ○STRJパッケージロードマップと3つのキーワード	まとめ ○質疑応答口	

本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信となります。予め「Zoom」のインストールが可能か、接続可能か等をご確認ください。セミナー資料は電子ファイルでの配布、郵送のいずれかになります。詳細はホームページをご確認下さい。

■2名同時申込みで1名分無料■  
(1名あたり定価半額の24,750円)

※2名様ともS&T会員登録をしていただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。  
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。  
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。  
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。  
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

**セミナー申込用紙 B201078 (半導体パッケージ)**

会社名 団体名			
部署			
役職			〒
ふりがな	住所		
氏名			
TEL	FAX		
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。		

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。  
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

<b>今後のご案内</b>	
<input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み	S&T会員価格を 適用いたします。 (E-mailアドレス必須)
<input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み	
<input type="checkbox"/> 希望しない	
<b>お支払方法</b>	
<input type="checkbox"/> 銀行振込 (振込予定日 月 日)	
<b>通信欄</b>	

●受講料について  
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。  
●お申込みについて  
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。  
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。  
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。  
●お支払いについて  
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。  
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。  
振込手数料はお客様が負担ください。

●個人情報の取り扱いについて  
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。  
詳しくはホームページをご覧ください。  
●キャンセル規定  
開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、  
・開催7日前以前でのキャンセル: キャンセル料はいただきません。  
・開催3~6日前でのキャンセル: 受講料の70%  
・開催当日~2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%  
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

**サイエンス & テクノロジー**  
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍  
サイエンス&テクノロジー株式会社  
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187  
〒105-0013  
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F  
http://www.science-t.com